



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20100518000
2010 年 8 月 9 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタマドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

HPA/PWR SOIC(8/14 ピンD, 20 ピンDW) パッケージ 一部製品 組立サイト追加のご案内

(初版 PCN20100518000 2010 年 5 月 25 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しくお願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての最終版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知の 30 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice
変更概要	Design/Specification	☐ Design ☐ Electrical ☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site ☐ Process ☐ Material
	☒ Assembly	☒ Site ☐ Process ☐ Material
	Test	☐ Site ☐ Process
	☒ Others	☒ Packing/Shipping/Labeling ☐ -
変更内容	HPA/PWR SOIC(8/14 ピン D, 20 ピン DW) パッケージ 一部製品 組立サイト追加 現行 : TI-Taiwan(台湾) 変更後 : TI-Taiwan(台湾), TI-Malaysia(マレーシア)	
対象製品	対象製品リスト参照	
変更時期	9 月中旬の出荷より予定しています。	
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了
製品表示	☐ 変更無し	☒ 変更あり
備考	-	

変更内容

内容：弊社 HPA(ハイパフォーマンスアナログ)及びPWR(パワーマネジメント) SOIC(8/14ピンD, 20ピンDW)パッケージ 一部製品の組立サイトについて、現行 TI-Taiwan(台湾)サイトにおいて製造いたしておりますが、供給能力確保の為に、これに加えて、TI-Malaysia(マレーシア)サイトを追加し認定しました。また、初版通知 TLV3402IDR/TLV3402IDRG4 2製品については、下記の通り変更対象から除外しました。TI-Malaysiaサイトにおいて、SOICパッケージ製品は認定されています。下記信頼性試験結果(2004年11月7日、2008年1月13日終了)を参照下さい。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
組立サイト

現行
TI-Taiwan(台湾)

変更後
TI-Taiwan(台湾)
TI-Malaysia(マレーシア)

理由：供給能力確保の為

対象製品リスト

対象製品名 ☐ : 認定終了品 取消線・右詰: 対象除外品				
HPA00299DR	TLC274ACD	TLC27L4AIDG4	TLE2072AIDG4	TPS2812DR
SN65HVD1050D	TLC274ACDG4	TLC27L4AIDR	TLE2072AIDR	TPS2812DRG4
SN65HVD1050DG4	TLC274ACDR	TLC27L4AIDRG4	TLE2072AIDRG4	TPS2814D
SN65HVD1050DR	TLC274ACDRG4	TLC27L4BCD	TLE2072CD	TPS2814DG4
SN65HVD1050DRG4	TLC274AID	TLC27L4BCDG4	TLE2072CDG4	TPS2814DR
SN65HVD33D	TLC274AIDG4	TLC27L4BCDR	TLE2072CDR	TPS2814DRG4
SN65HVD33DG4	TLC274AIDR	TLC27L4BCDRG4	TLE2072CDRG4	TPS3705-30D
SN65HVD33DR	TLC274AIDRG4	TLC27L4BID	TLE2072ID	TPS3705-30DG4
SN65HVD33DRG4	TLC274BCD	TLC27L4BIDG4	TLE2072IDG4	TPS3705-30DR
TLC0838CDW	TLC274BCDG4	TLC27L4BIDR	TLE2072IDR	TPS3705-30DRG4
TLC0838CDWG4	TLC274BCDR	TLC27L4BIDRG4	TLE2072IDRG4	TPS3707-30D
TLC0838CDWR	TLC274BCDRG4	TLC27L4CD	TLV3402CD	TPS3707-30DG4
TLC0838CDWRG4	TLC274BID	TLC27L4CDG4	TLV3402CDG4	TPS3707-30DR
TLC0838IDW	TLC274BIDG4	TLC27L4CDR	TLV3402CDR	TPS3707-30DRG4
TLC0838IDWG4	TLC274BIDR	TLC27L4CDRG4	TLV3402CDRG4	TPS7101QD
TLC0838IDWR	TLC274BIDRG4	TLC27L4ID	TLV3402ID	TPS7101QDG4
TLC0838IDWRG4	TLC274CD	TLC27L4IDG4	TLV3402IDG4	TPS7101QDR
TLC084AID	TLC274CDG4	TLC27L4IDR	TLV3402IDR	TPS7101QDRG4
TLC084AIDG4	TLC274CDR	TLC27L4IDRG4	TLV3402IDRG4	TPS76633D
TLC084AIDR	TLC274CDRG4	TLC7733IDR	TLV5638CD	TPS76633DG4
TLC084AIDRG4	TLC274ID	TLC7733IDRG4	TLV5638CDG4	TPS76633DR

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

TLC084CD	TLC274IDG4	TLC7733QD	TLV5638CDR	TPS76633DRG4
TLC084CDG4	TLC274IDR	TLC7733QDG4	TLV5638CDRG4	TPS76801QD
TLC084CDR	TLC274IDRG4	TLC7733QDR	TLV5638ID	TPS76801QDG4
TLC084CDRG4	TLC27L4ACD	TLC7733QDRG4	TLV5638IDG4	TPS76801QDR
TLC084ID	TLC27L4ACDG4	TLE2072ACD	TLV5638IDR	TPS76801QDRG4
TLC084IDG4	TLC27L4ACDR	TLE2072ACDG4	TLV5638IDRG4	
TLC084IDR	TLC27L4ACDRG4	TLE2072ACDR	TPS2812D	
TLC084IDRG4	TLC27L4AID	TLE2072AID	TPS2812DG4	

製品表示

今回の変更に伴い、出荷ラベルに記載の原産地コード(ラベル箇所:22L, 23L)及び製品捺印が下記の様になります。

	組立サイト	組立サイトコード(22L)	組立国コード(23L)
現行	TI-Taiwan	ASO: TAI	ACO: TWN
追加認定	TI-Malaysia	ASO: MLA	ACO: MYS



図1 出荷ラベルの例

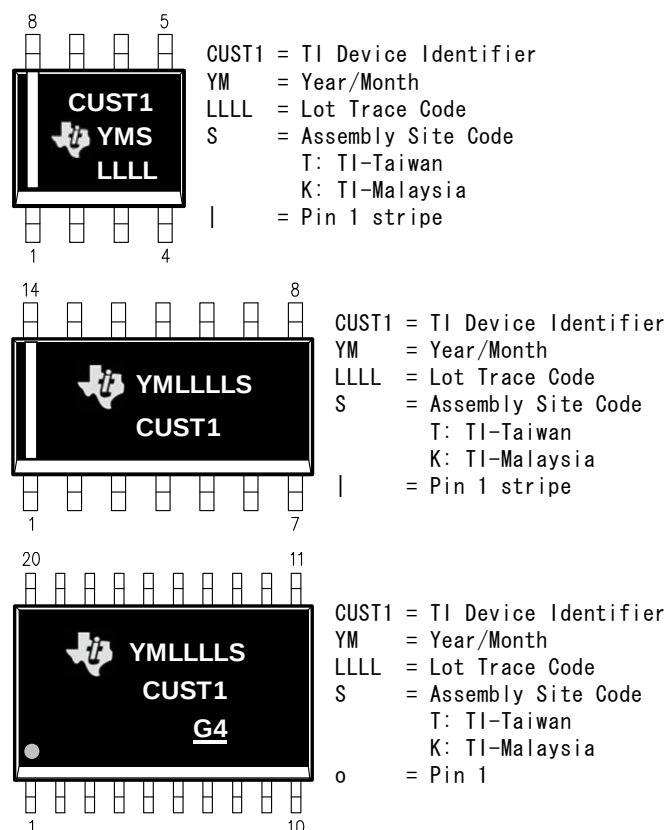


図2 捺印表示の例 (8/14 ピン D, 20 ピン DW パッケージ)

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 1 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	TLC7733ID	Die Size (mm):	1.448 X 1.753	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Assembly MQ	Per AT site spec. (MLA)		Approved	
Yield Evaluation	FT yield & Bin summary		Approved	

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 1 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS3705-30D	Die Size (mm):	1.168 X 1.270	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Assembly MQ	Per AT site spec. (MLA)		Approved	
Yield Evaluation (TPS3705-30D)	FT yield & Bin summary		Approved	

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 1 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TLV5638D	Die Size (mm):	1.88 X 2.24	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
Assembly MQ	Per AT site spec. (MLA)		Approved	
Manufacturability	Test MQ		Approved	

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 4 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1		Device2	
Qual Device:	TPS2812D		TPS2814D	
Die Size (Mils):	47 X 57		47 X 57	
Die Protective Coating:	10 KA N		10 KA N	
Assembly Site:	TI Malaysia		TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/8		SOIC/D/8	
Mount Compound:	4042500		4042500	
Mold Compound:	4205694		4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au		0.96 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu		NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Device1	Device2	
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification	Approved	Approved	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2010 年 8 月 5 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1		Device2	
Qual Device:	TLC0838CDWR		TLC274IDR	
Die Size (Mils):	2.03 X 2.03		2.77 X 1.75	
Die Protective Coating:	10 KA CN		-	
Assembly Site:	TI Malaysia		TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/DW/20		SOIC/D/14	
Mount Compound:	4042500		4042500	
Mold Compound:	4205694		4205694	
Bond Wire:	0.96 Mil Dia., Au		0.96 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu		NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration		Sample Size/ Fails	
			Device1	Device2
Manufacturability (Assembly)	per mfg. Site specification		Approved	Approved
Manufacturability (Test)	per mfg. Site specification		-	Approved

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2085D	Die Size (mils):	54 X 72 (dual die)	
Assembly Site:	TI Taiwan	Package/Code/Pins:	SOIC/D/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	-
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	-
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	SN75976A1DL	Die Size (mils):	301 X 122	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DL/56	
Mount Compound:	4147858	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	116/0	116/0	116/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -3 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2211ADB	Die Size (mils):	118 X 63	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/16	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信賴性試驗結果				
信賴性試驗期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信賴性試驗 — 試料構成詳細				
Qual Device:	TPS2201DB	Die Size (mils):	142 X 204	
Die Protective Coating:	10KACN	-	-	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DB/30	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	2.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-1/260C	-	-	
信賴性試驗結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Life Test	155C, 240 Hours	40/0	40/0	40/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	40/0	40/0	40/0
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -1 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2004 年 11 月 7 日
信頼性試験 — 試料構成詳細				
Qual Device:	BQ3285ESS	Die Size (mils):	88 X 105	
Assembly Site:	TI Malaysia	Package/Code/Pins:	SSOP/DBQ/24	
Mount Compound:	4042500	Mold Compound:	4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au	Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu	
MSL :	JEDEC L-2/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
**Autoclave	121C, 240 Hours	77/0	77/0	77/0
**Thermal Shock	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	77/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	170C, 420 hours	77/0	77/0	77/0
Flammability	UL 94 V-0	5/0	5/0	5/0
	IEC 695-2-2	5/0	5/0	5/0
Manufacturability Qualification (MQ)	-	Approved		
Notes: ** Preconditioning Sequence, JEDEC Level -2 /260C				

信頼性試験結果				
信頼性試験期間	開始	—	終了	2008 年 1 月 13 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Device ID:	Device1		Device2	
Qual Device:	MSA00021DG4		LM2901QDG4Q1	
Die Size (Mils):	81 X 131		48 X 49	
Die Protective Coating:	10KACN		10KACN	
Assembly Site:	TI Malaysia		TI Malaysia	
Package/Code/Pins:	SOIC/D/16		SOIC/D/14	
Mount Compound:	4042500		4147858	
Mold Compound:	4205694		4205694	
Bond Wire:	1.0 Mil Dia., Au		0.8 Mil Dia., Au	
Leadframe (Finish, Base):	NiPdAu, Cu		NiPdAu, Cu	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Device1/Lot1	Device1/Lot2	Device2
**Life Test	150C, 408 Hours	77/0	77/0	77/0
**HAST	130C/85%RH, 96 Hours	77/0	77/0	77/0
**Autoclave	121C, 96 Hours	231/0	77/0	77/0
**Temp Cycle	-65/150C, 1000 Cycles	231/0	77/0	77/0
**High-Temp Storage	150C, 1000 Hours	231/0	-	-
Solderability	>95% coverage, 8 hour Steam Age	22/0	22/0	22/0
Physical Dimensions	-	10/0	10/0	10/0
Manufacturability (Assembly)	-	-	Approved	-
Notes: ** Preconditioning sequence, JEDEC Level -1/260C				